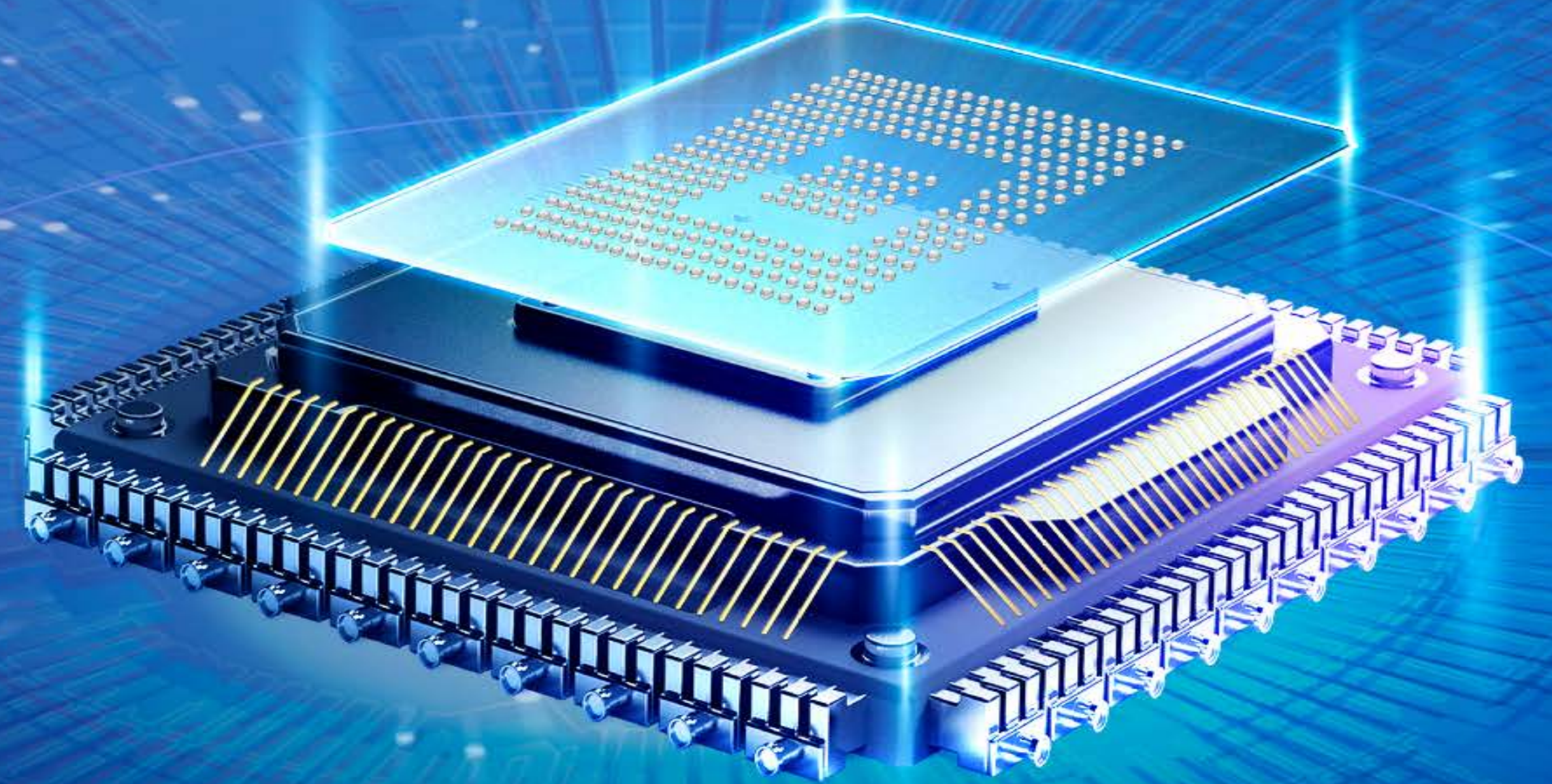




MK ELECTRON

2025

IR Book



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에 정보제공을 목적으로 엠케이전자(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재 배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무 실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융위원회에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다

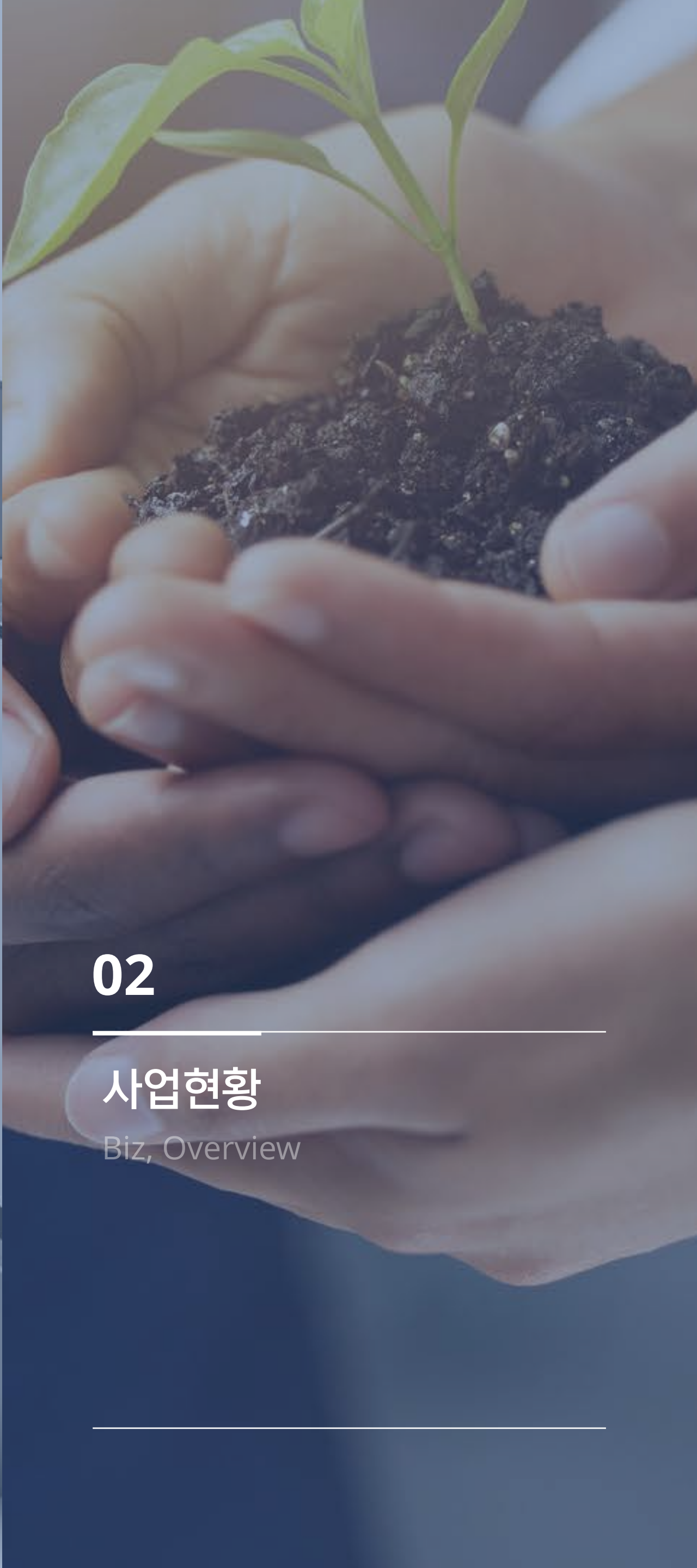




01

회사소개

Company Introduction



02

사업현황

Biz, Overview



03

신규사업

New Biz, Introduction



04

매출현황

Sales Status



Company Introduction

회사 소개

회사 개요

- 대표이사 현기진
- 법인설립 1982년 12월
- 주요사업 반도체 및 전기전자 소재업
- 매출규모 '24년 7,615억 (본사+중국법인)
(연결기준 : 1조 1,170억원)
- 임직원수 463명 (중국법인 : 173명)
- 사업장 국내 - 용인 (본사) 안산 (연구) 해외 - 대만 (지사)
 음성 (재생) 시흥 (도금) 중국 (법인)



어플리케이션

Company Overview

과거, 현재와 미래를 잇는 연결고리 MKE Products



PC



Smart Phone



IOT



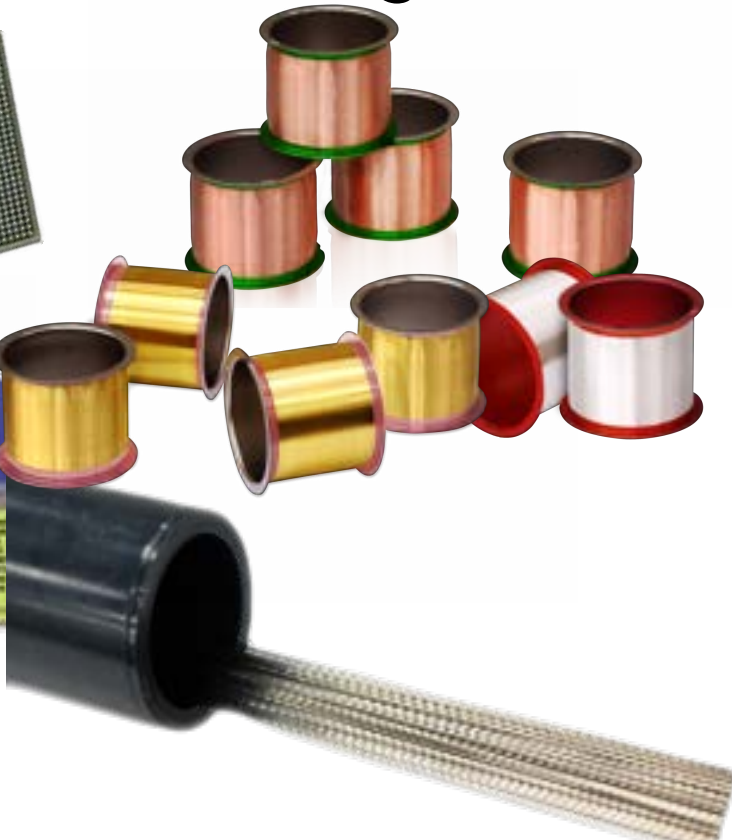
Automotive

Solder Ball



Solder Paste

Bonding Wire



Palladium Alloy Wire (Pogopin Wire)

Secondary Battery Cathode Material



AI



Robot



Super Computer



Automated Driving

고객사 현황

Company Overview

글로벌 반도체 공급망, 이원화 전략



MK ELECTRON CO., LTD.



IDM & Foundry







Assembly







Fabless



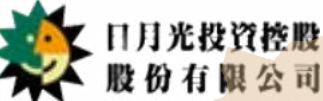


MK Electron (Kun Shan) Co., Ltd.



IC&OSAT









CAMARA MODULE





信利光电股份有 公

Value Chain

Company Overview

반도체 공급망, 핵심 소재 공급 + 빅테크 신규 반도체 칩 설계 참여



BIZ. Overview

사업 현황

Bonding Wire & Solder Ball

Semiconductor Packaging Biz. Overview

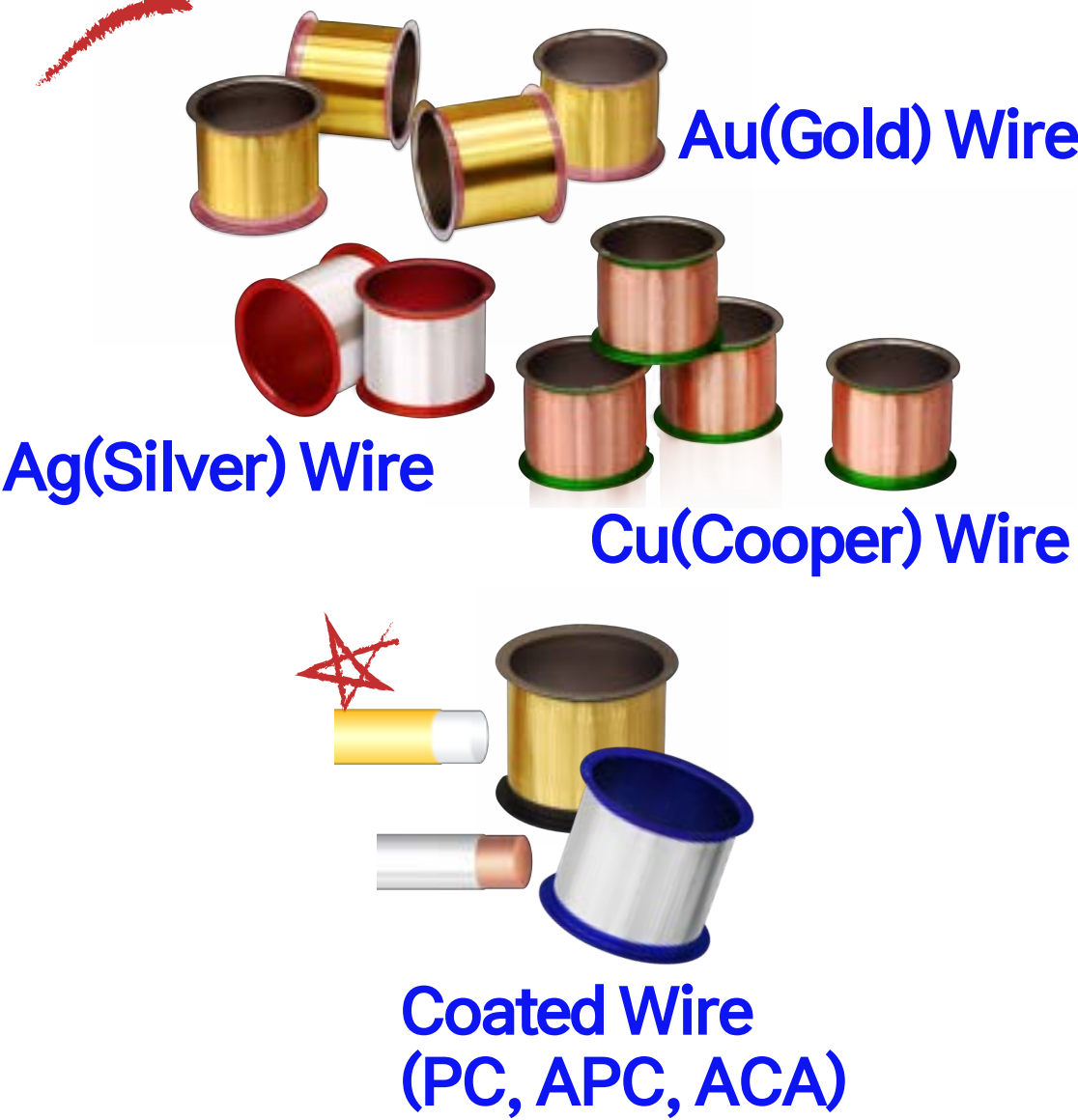
초미세 기술을 시작으로 혁신을 더하다

Solder Paste



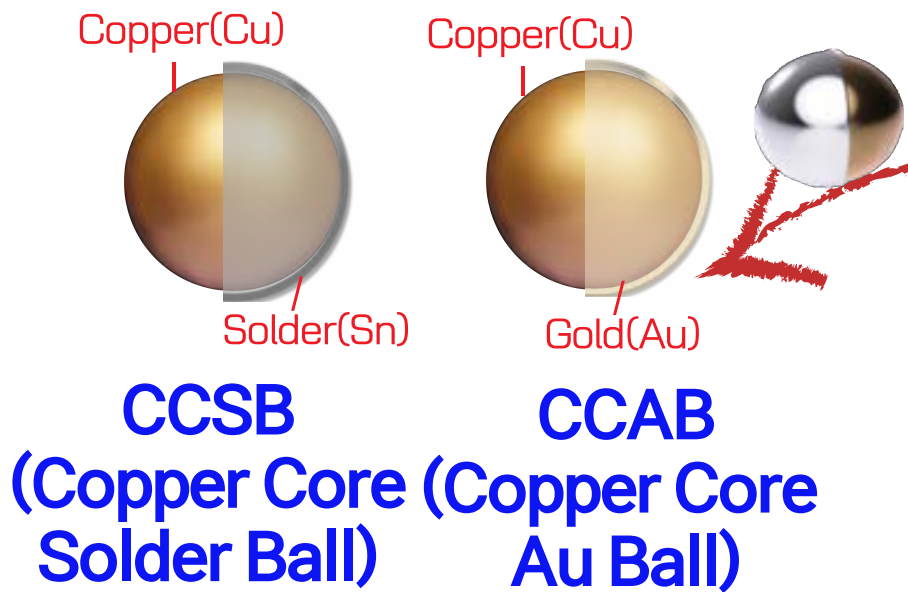
차세대 반도체 소재, SMT 소형화, 국내순수기술

Bonding Wire



높은 수율, 내구성, 안정성, 효율성...

Core Ball



반도체 쏫티지

Solder Ball

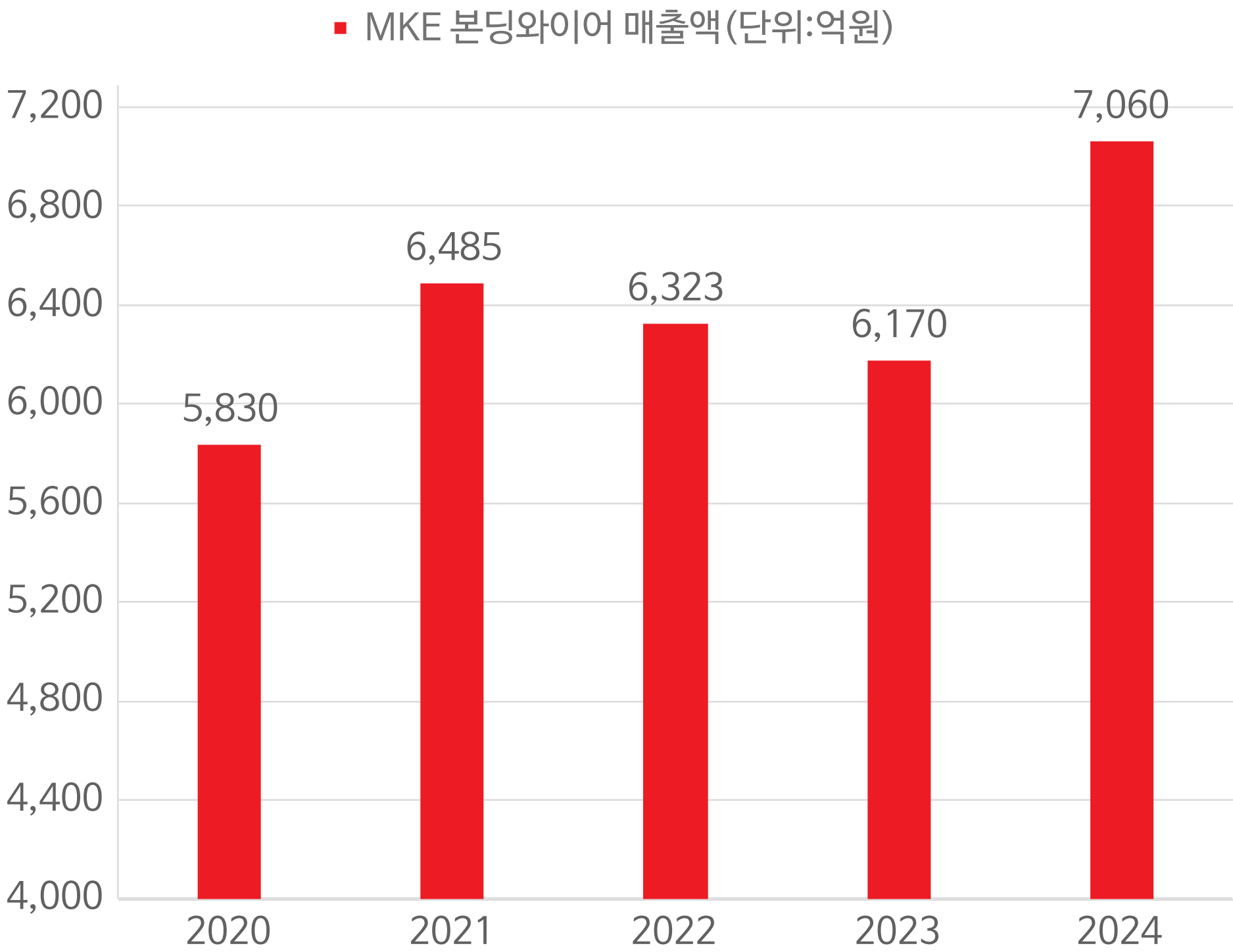


다양성(Ball Size), 저융점, 고신뢰성....

Bonding Wire

Biz. Overview

레거시 반도체 + 최신 반도체 Chip 활용도 증가



Coated Wire 비중 증가에도 물량 상승으로 매출 지속 증대

AI Chip (가속기 외)

양자 컴퓨터

SOCCAM

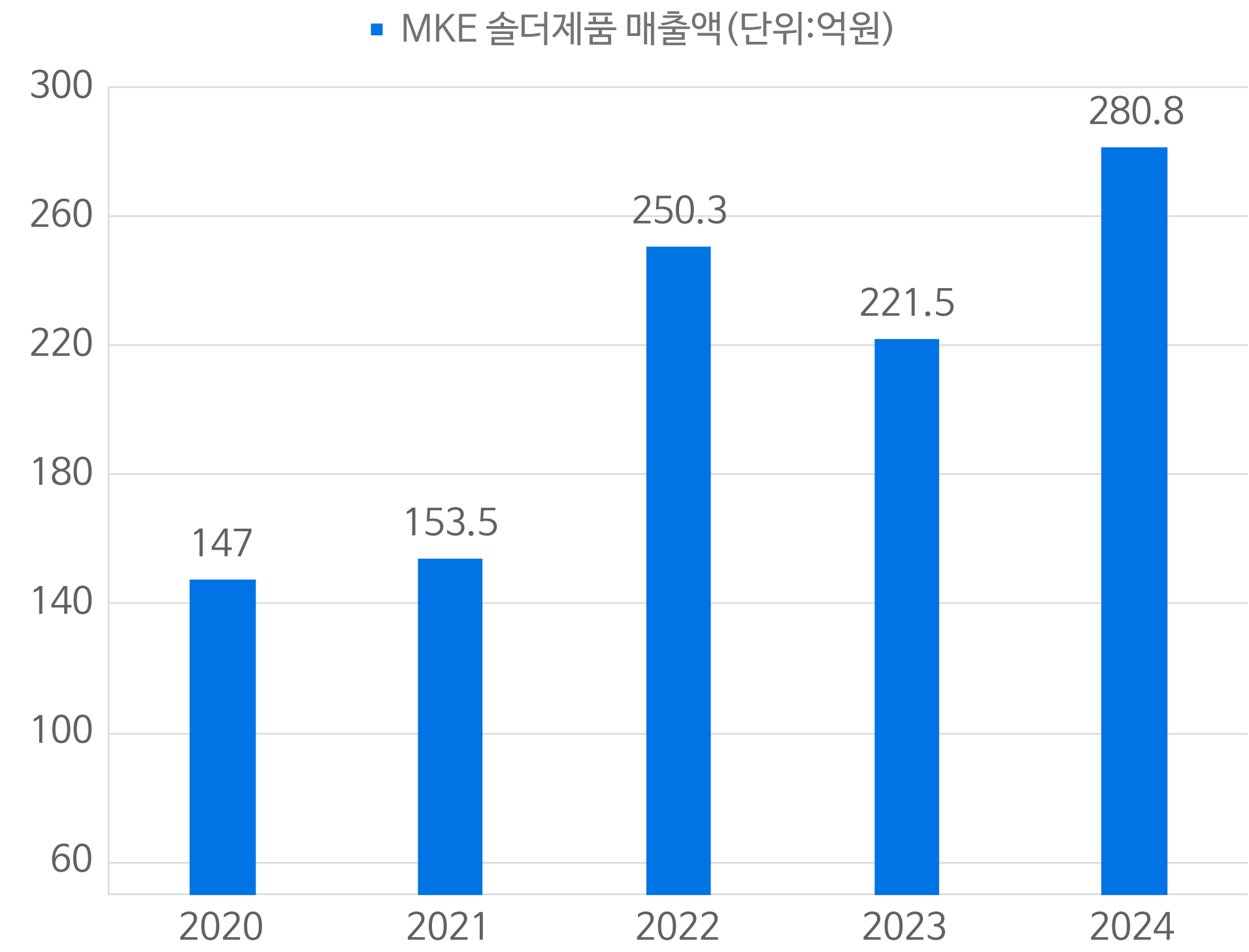
HBM (VFO)

신뢰성, 효율성으로 AI, 양자컴퓨터 Chip, SOCCAM, HBM 등 첨단 반도체 활용

Solder Ball

Biz. Overview

반도체 Chip 특성에 맞는 조성 및 Size 맞춤형 전략



Ball Size 100 ~ 760um과 다양한 조성의 패키징 맞춤형 솔더볼 생산



High end PKG(서버, Ai, HBM 등) 시장 성장에 따라 저융점, 고온신뢰성, 외부 충격에 따른 내구성 우수한 Solder Ball 요구 증대

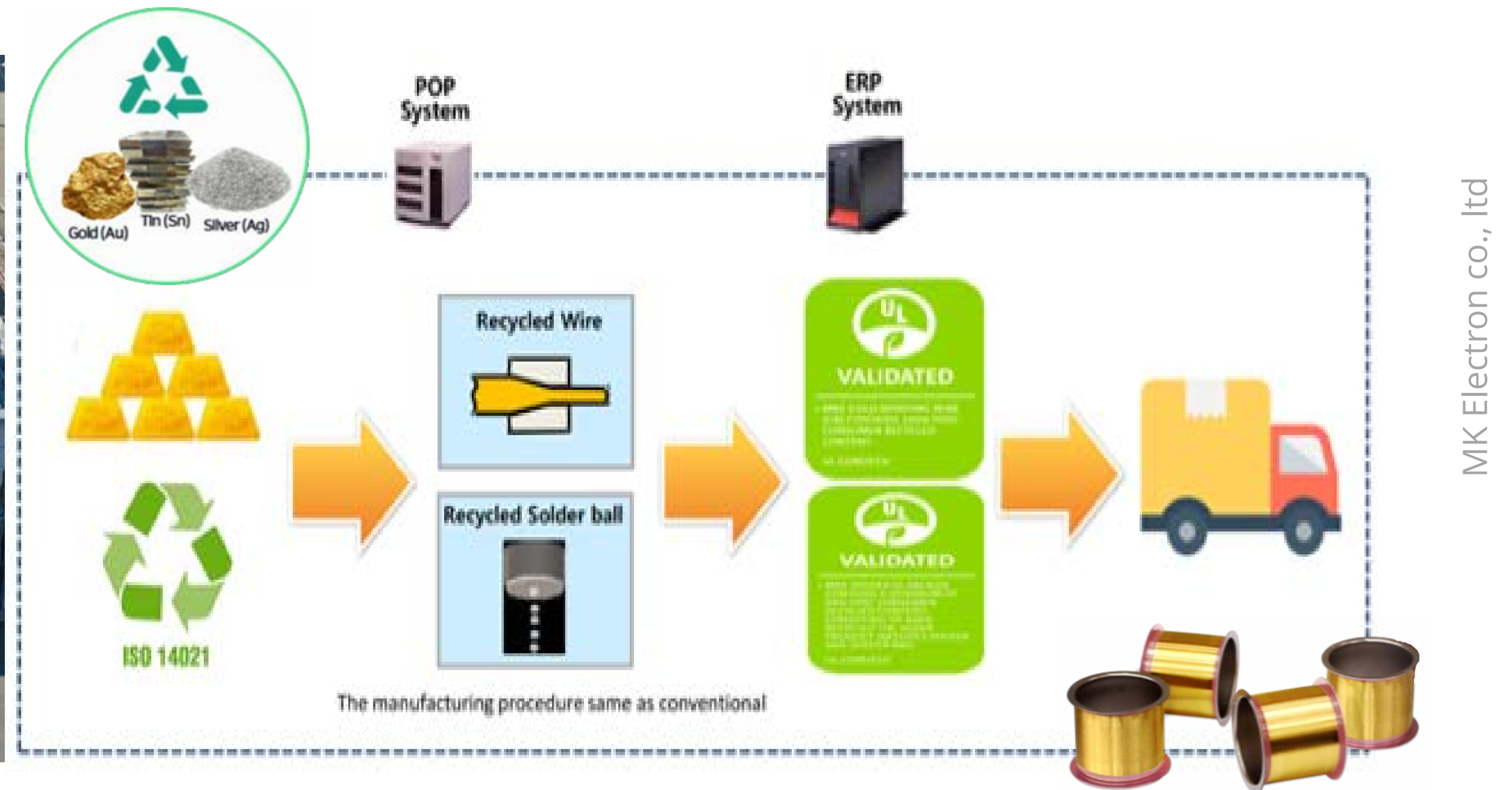
Eco – Friendly Biz Biz. Overview

친환경 제품 및 리사이클 Biz 강화



음성 재생 센터 - 탄소 저감 위한 금속 계열 재원료화 기술 고도화

- ① 재생 원료 사용 G 시리즈 Bonding Wire, Solder Ball 출시 (2023년)
- ② ECV (Environmental Claims Validation) 인증 완료 (2023년)
- ③ PCF (Product Carbon Footprint) 검증 완료 (2024년)



Big Tech 기업의 지속적인 탈탄소화 제품 요구

폐기물 원료 수거 => 재생 => 제품화 하는 Close Loop 생태계 구축

고객 협업을 통한 반도체 공급망 내 Close Loop 구성으로 재생 사업 매출 확대



New Biz, Introduction

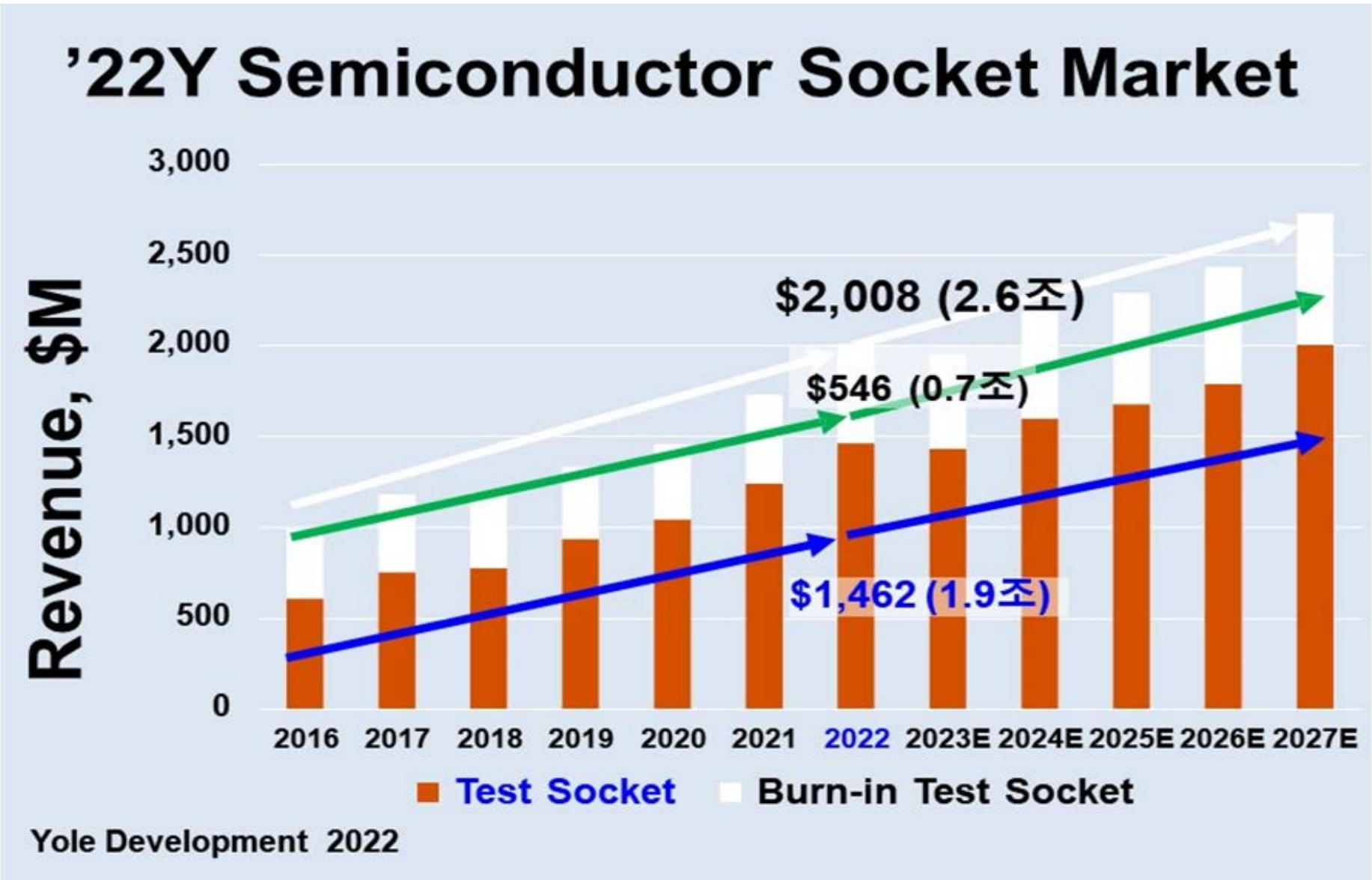
신규 사업

SPM / Solder Paste /
Secondary battery anode material

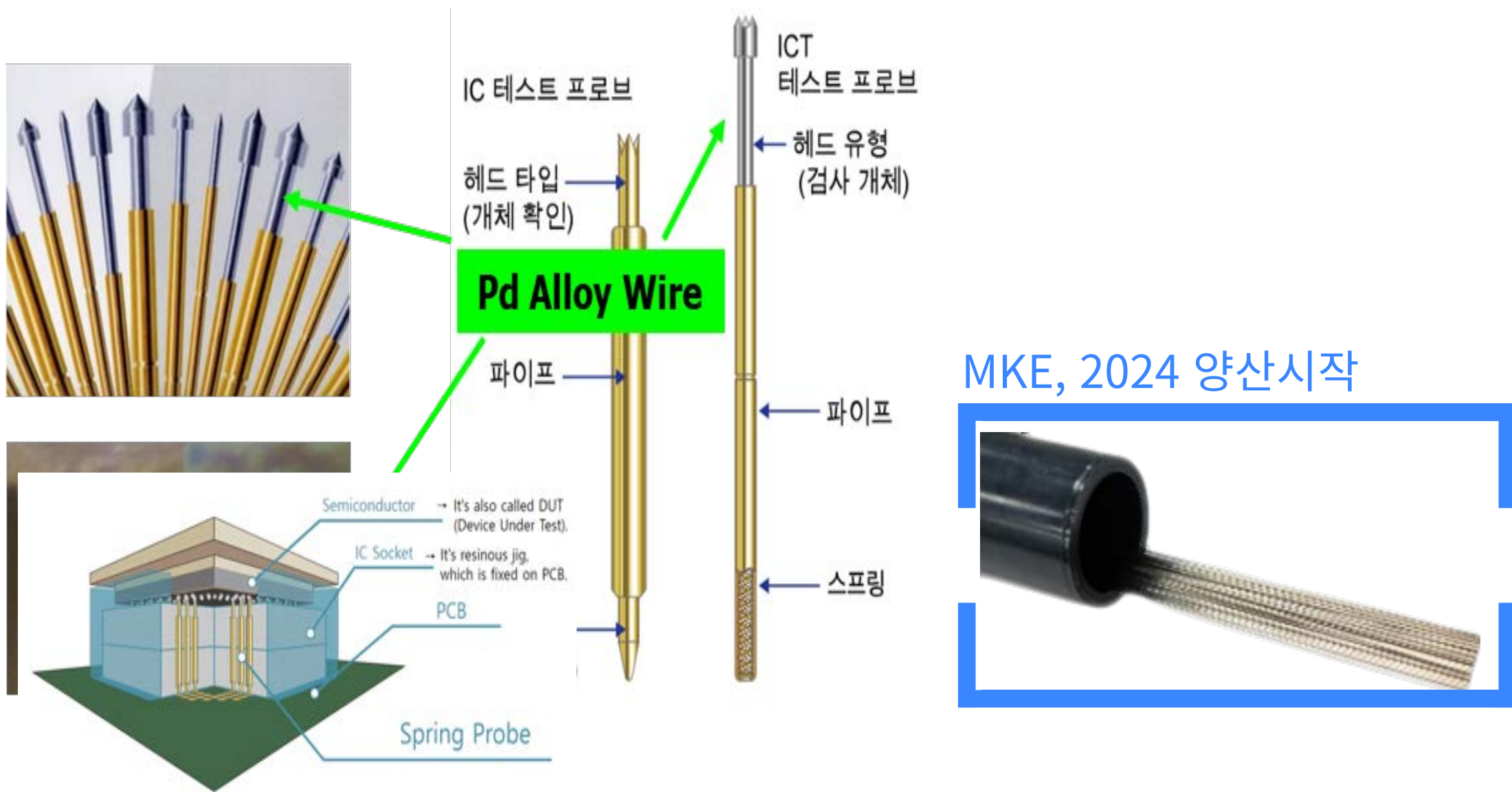
PAW (Palladium Alloy Wire)

New Biz. Overview

반도체 테스트 시장 성장으로 수요 증가 기대



반도체 기술 진화 (미세화, 고집적화 등)로 반도체 테스트 소켓 수요 증가
반도체 테스트용 소켓 시장 규모(2022년) 약 1.9조 원, 연간 4.5% 성장 예상



엠케이전자 Bonding Wire, Solder Ball 노하우로 반도체 테스트 소켓용 부품
포고핀(Pogo Pin) 사용되는 팔라듐 합금 와이어 제품 신규 개발 완료

Solder Paste

SMT, 반도체 차세대 접합소재

New Biz. Overview

솔더 Paste 시장



솔더볼 시장 대비 7배 ↑
대부분 수입 의존

글로벌 리더 (Top 10)

A사	미국	12.50%
B사	일본	9.80%
C사	일본	5.60%
D사	독일	5.10%
E사	중국	7.30%
F사	캐나다	4.80%
G사	중국	6.40%
H사	미국	3.30%
I사	일본	3.00%
J사	대만	3.10%
K사	일본	2.20%
기타	-	37.00%



Solder Powder

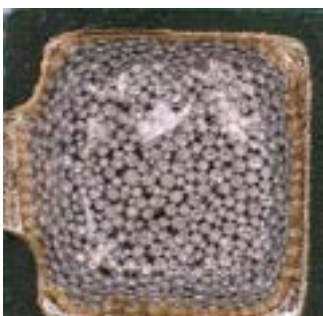
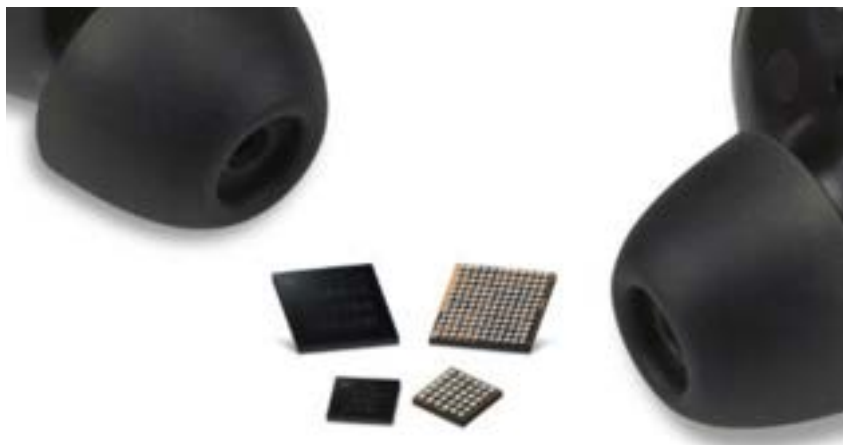


Flux (Resin)

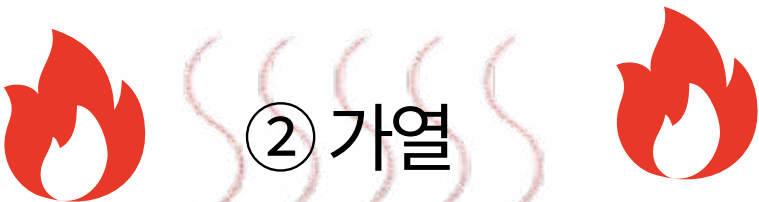
=



Solder Paste

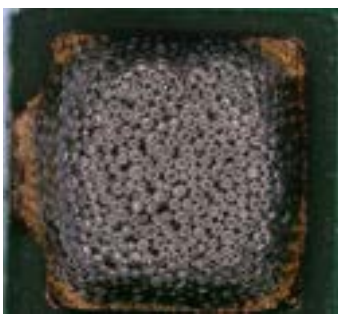


① Paste 도포



② 가열

③ 실장



SALES STATUS

연결/별도 매출현황

MK ELECTRON CO.,LTD